

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025 年年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：以公司目前总股本扣除公司回购产生的库存股后作为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计人民币78,170,880.72元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.15%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
联系地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
传真	0512-67730808	0512-67730808
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2、 报告期公司主要业务简介

公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

（一）半导体整体市场情况

根据美国半导体行业协会(SIA)发布数据,2025 年全年全球半导体行业销售额首次突破 7,000 亿美元大关,达 7,917 亿美元,同比增长 25.6%。预计 2026 年仍将实现加速增长至 9,754 亿美元,逼近万亿美元。AI 时代浪潮下,以存储、光模块等为代表的 AI 基础设施硬件与汽车智能化背景下的汽车电子为核心增长引擎。

图一 2025 年全球半导体行业销售额



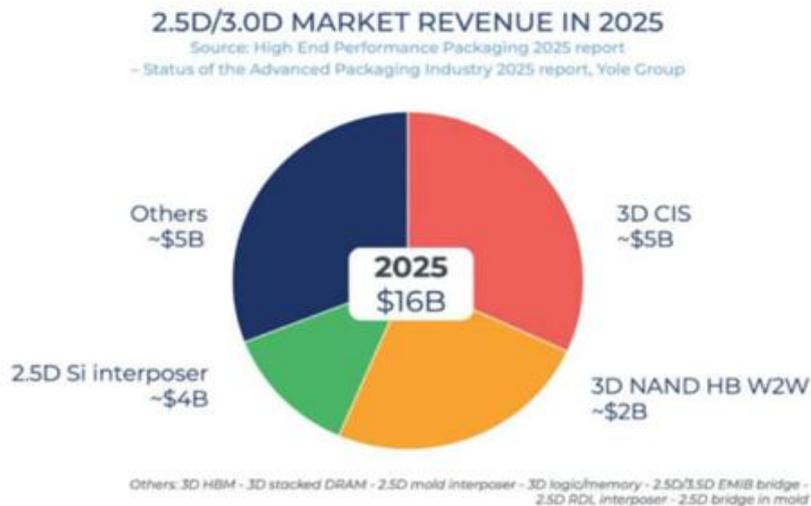
数据来源：全球半导体贸易统计协会（WSTS）

从地区来看,2025 年美洲和亚太地区引领产业增长,增长率分别为 30.5%和 45.0%。相比之下,欧洲呈现温和增长,增长率为 6.3%,日本销售额有所下降,下降幅度为 4.7%。

从细分市场来看,2025 年几个半导体产品细分市场表现突出,其中逻辑产品销售额增长 39.9%,达到 3,019 亿美元,成为销售额最大的产品类别。存储器产品销售额位居第二,2025 年增长 34.8%,达到 2,231 亿美元,这两大市场均受到 AI、云基础设施、先进消费电子产品等领域持续需求的推动。

聚焦到封测产业发展情况,根据 Yole 的报告,先进封装将扮演日益重要的角色,预计全球先进封装 2024 - 2030 年市场规模预计由约 460 亿美元扩容至约 800 亿美元。其中,根据 Yole 的预计 2025 年全球 2.5D、3.0D 先进封装市场规模约为 160 亿美元。在这一过程中,受益于 3D 堆叠技术利用 TSV（硅通孔）实现了最短的垂直互连距离,消除了 Chiplet 之间的横向通信延迟（Inter-chiplet latency）问题,驱动 2.5D/3D 封装将以远高于行业均值的复合增速快速放量,成为 AI 服务器、HBM 及高性能计算（HPC）需求外溢的主要载体,全球先进封装已演变为承接摩尔定律与 AI 算力扩张的核心增量环节。

图二 2025 年全球 2.5D、3.0D 先进封装市场收入



数据来源：YOLE

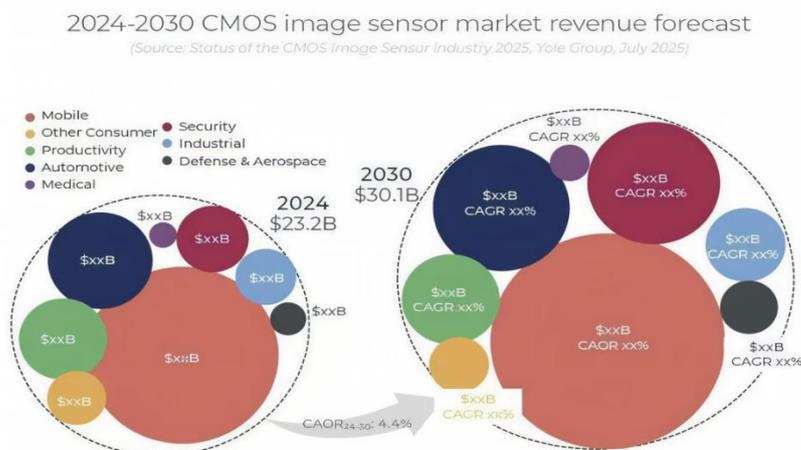
(二) 公司所处细分市场情况

1、传感器市场

公司专注于集成电路先进封装技术，拥有领先的硅通孔（TSV）、晶圆级、Fanout、系统级等多样化的封装技术，具备为客户构建完整的传感器芯片的异质集成能力，聚焦于以影像传感芯片为代表的传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防监控数码、汽车电子、机器人、AI 眼镜等市场领域。

根据研究机构 YOLE 在 2025 年发布的报告，从全球 CIS 出货量来看，2025 年前三季度出货量为 63.5 亿颗，同比增长 4%，预计 2025 年全年出货量将达 89 亿颗；从全球 CIS 市场收入来看，2024 年全年收入达 232 亿美元。相关机构预计至 2030 年，全球 CIS 市场将保持平稳增长到 301 亿美元，但产品结构将发生较大变化，受益于汽车智能化趋势推动，汽车与工业视觉将成为增量主力，手机占比继续下降但仍是最大单品市场。

图三 2024-2030 年全球 CIS 销售额预测



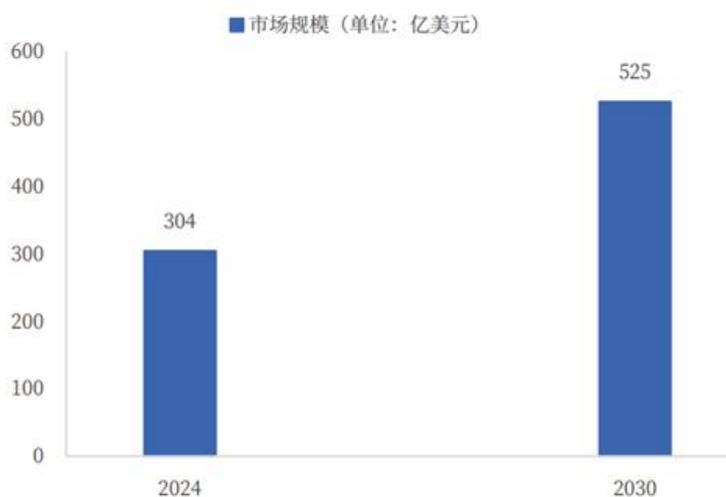
数据来源：YOLE

2、光学器件市场

精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件发展迅速，其应用范围包括照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品，近年来消费级精密光学作为智能手机、安防监控摄像头、车载摄像头等产品的核心部件，成为影响终端产品应用效果的重要因素；

与此同时随着工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR 检测等新兴领域的市场需求增长，工业级精密光学将迎来快速发展趋势，产业发展空间广阔。根据 Global Industry Analysts 数据，2024 年全球精密光学的市场规模为 304.0 亿美元，预计 2030 年市场规模将达到 525.0 亿美元，对应 2025-2030 年 CAGR 为 9.5%。

图四 全球工业级精密光学市场规模



数据来源: Global Industry Analysts

(一) 主营业务

公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用于手机、安防监控、身份识别、汽车电子、机器人、AI 眼镜、全景式相机等电子领域。同时，公司通过并购及业务技术整合，有效拓展微型光学器件的设计、研发与制造业务，并拥有一站式的光学器件设计与研发，完整的晶圆级光学微型器件核心制造能力，相关产品广泛应用于半导体设备、工业智能、车用智能投射等应用领域。

(二) 经营模式

公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是 IDM 模式，由 IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。对于公司拓展的微型光学器件业务，公司根据客户的需求，进行光学器件的设计、研发，自行采购原辅材料，由生产部门按照设计参数与技术工艺标准进行生产制造，完工检验后将光学器件出售给客户，并向客户收取产品销售货款，公司与客户签署产品销售合同，约

定产品采购数量、销售单价等事项。

销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测方案设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事项。对于微型光学器件业务，公司根据客户的需求进行光学器件产品的设计、开发与生产，并向客户进行产品销售出货，公司与客户建立合作关系时，双方签署采购订单或合同，约定产品的采购数量、价格等。

采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

（三）公司所处产业链环节

公司封装业务所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户；材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

公司光学器件业务上游主要为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过精密加工，生产成光学元件及镜头等产品的环节；下游主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	5,172,547,549.51	4,748,335,144.33	8.93	4,824,122,558.00
归属于上市公司股东的净资产	4,608,200,142.42	4,275,578,652.58	7.78	4,088,742,566.33
营业收入	1,473,887,081.78	1,129,957,381.01	30.44	913,288,878.20
利润总额	418,264,949.58	278,559,829.69	50.15	160,819,750.87
归属于上市公司股东的净利润	369,617,694.92	252,758,312.83	46.23	150,095,690.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	328,237,804.93	216,521,823.84	51.60	115,945,279.82
经营活动产生的现金流量净额	483,929,390.85	355,479,310.56	36.13	305,581,902.42
加权平均净资产	8.33	6.05	增加2.28个百分点	3.72

产收益率 (%)			点	
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.39	46.15	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.39	46.15	0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	290,803,813.80	376,415,388.74	398,739,144.27	407,928,734.97
归属于上市公司股 东的净利润	65,356,761.36	99,506,641.51	108,887,262.24	95,867,029.81
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	54,998,864.08	96,019,616.51	94,851,706.85	82,367,617.49
经营活动产生的现 金流量净额	61,582,283.99	97,398,818.21	150,728,495.02	174,219,793.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)					143,132		
前十名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中新苏州工业园区 创业投资有限公司	0	102,849,766	15.77		无		国有法 人
香港中央结算有限 公司	1,222,774	7,029,358	1.08		未知		未知
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资基金	605,025	5,993,836	0.92		未知		未知
丁贤平	1,173,700	4,168,616	0.64		未知		未知

国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	-3,262,143	4,061,059	0.62		未知		未知
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	889,700	3,779,804	0.58		未知		未知
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	3,027,400	3,027,400	0.46		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	472,900	2,711,900	0.42		未知		未知
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,656,061	0.41		未知		未知
中国银行股份有限公司—中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	2,359,376	2,359,376	0.36		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片、射频芯片等，相关产品广泛应用于汽车电子、AIOT（安防监控数码等）、智能手机、身份识别等市场领域。

2025年在数据、算力、存储、智能传感等市场需求驱动下，全球半导体产业规模恢复增长，作为半导体行业的重要组成部分，以图像传感器（CIS）为代表的智能传感器市场，整体市场也保持增长势头。在此背景下，公司2025年通过技术持续创新、不断拓展新的应用市场，整体业务恢复快速增长趋势，尤其是随着汽车智能化的快速推进，公司在车用CIS领域的技术领先优势不断提升、业务规模快速增长，带动公司业务规模与盈利能力实现快速增长。报告期内，公司实现销售收入147,388.71万元，同比增加30.44%，实现营业利润41,847.48万元，同比增加45.16%，实现归属于上市公司股东的净利润36,961.77万元，同比增加46.23%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用